

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	√特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（ ）
参与单位名称	申万宏源、华福证券、誉辉资本、德邦证券、宁家资产、沃珑港资产、山西证券、菁菁投资、华鑫证券、安信证券、博颐投资、西部证券自营、深圳优雅众福、首创证券、国海证券、金信基金、云杉投资、海通资管、海通证券、信达证券、禹合资产、上银基金、中银基金、磐耀资产、恒越基金、九泰基金、Goldman Sachs、高华证券、国元证券、国益证券、申万菱信、交银基金、星石投资、富恩德资产、信银理财、天风证券、财通证券资管、健顺投资、圆信永丰基金、西南证券、澄明资产、民生证券、万家基金、中银资管、高毅资产、国信证券、中海基金、国投瑞银、国金证券、五地投资、天华投资、东海证券、混沌投资、重阳投资、海创基金、道仁资本、博道基金、五地投资、中信建投、中庚基金、海通资管、野村资管、深招资产、歌斐资产、景顺长城基金、天安人寿、永盈基金、弘尚资产、施罗德投资、光大证券权益投资部、雷根基金、光证资管、亘曦资产、华泰证券、开源证券、寻常投资、拓璞投资、瞰道资产、宁泉投资、中信保诚、景熙资产、太平洋资产、永赢基金、建信保险资管、富国基金、野村东方国际证券资管部、华泰资管、深梧投资、中信建投、Schroders、鸿商资本、中泰自营、鲍尔太平、钧犀资本、鹏华基金、光大资管、华安基金、敦和资产、华福自营、德邦自营、远策投资、兴银理财、建信养老、创金合信、九泰基金、上银基金、中信证券、摩根士丹利、华泰保兴、泰信基金、晟盟资产、汇丰晋信、淳厚基金、招商基金、宝盈基金、西部利得、国联安基金、中信理财、中海基金、湘财基金、中融基金、上海鹤禧投资管理、磐厚动量、趣时资产
时间	2021年11月1日-11月30日
地点	中国（上海）自由贸易试验区碧波路690号2号楼304室
公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书：王珏 证券事务代表：徐闻

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>交流的主要问题及答复：</p> <p>Q：公司发布了一个比较特殊的开发套件 ESP32-S3-BOX，这是面向什么市场？</p> <p>A：公司推出的 AI 语音开发套件 ESP32-S3-BOX，旨在为用户提供了一个以离线和在线语音助手为核心的智能设备开发平台，能够助力用户降低研发投入成本，缩短开发周期，轻松构建可自定义 AI 语音功能的 AIoT 方案。它既可以用于构建智能音箱，也可以赋能更多物联网设备直接实现人机语音交互。</p> <p>Q：毛利率一直在小幅下降，主要原因是？</p> <p>A：毛利率下降是由产品结构变化导致，并非源于降价。目前公司产品结构上由销售芯片和公版模组构成。在今年上半年公司产能异常紧张的状态下，辅料产能也很紧张，越来越多的客户倾向于转为模组采购，导致模组占比有所提升。目前芯片的毛利率仍在 50%以上，模组毛利率在 30%左右，综合毛利率在 40%左右，目前是属于比较稳定的状态。我们有能力将上游成本端的上升及时转移到下游。我们的客户以保供为主，能够接受成本转移。</p> <p>Q：第四季度芯片占营收的比重会提高吗？</p> <p>A：这个很难确定，由客户需求决定。</p> <p>Q：接下来应该怎么看毛利率的走势？</p> <p>A：毛利率会平衡在目前的状态，因为模组并不会增多到让公司不再生产芯片的地步，毕竟这个市场上还有大量的模组厂商是乐鑫的下游。我们在定价策略上也要保护这些模组厂商的利益和发展空间。而且我们的模组也是委托模组厂生产的，他们仍然是生态链上重要的一环。</p> <p>Q：海外市场会不会因为一些因素导致需求可能短时间缩减？</p> <p>A：我们暂时没有看到的这样的缩减。目前看到的还是海外需求比较积极，有一些代工厂询价也会告知我们其实是某一个海外客户的订单。</p> <p>Q：公司三季度的晶圆交付有所延缓会影响到晶圆厂明年给我们增量的产能吗？</p> <p>A：明年产能会比今年多。</p> <p>Q：ESP32-C3 和 ESP32-S3 的放量是要等到明年吗？</p> <p>A：ESP32-C3 目前已经大批量出货。ESP32-S3 预计在明年开始放量。</p>
----------------------	--

Q: ESP32-C3 现在大概占整体出货量比例多少?

A: ESP32-C3 目前占比仍较小,但是出货量已达到每个月百万级以上。明年它的占比应该会更大一点,我们也是希望它能够快速进入月销量千万级的阵营中去,这是我们寄予厚望的一款产品线。

Q: 产能受晶圆的影响大,还是封测的影响大?

A: 受晶圆影响更大,封测在第三季度仍然有些紧张,在第四季度在开始缓解。

Q: 目前的研发费用比较高,与企业往后的成长有关,能不能分享一下新产品(比如 Wi-Fi 6)的状况?

A: 在明年 WI-FI 6(2.4G)的产品会量产,与此同时我们也在研发更高频段的 Wi-Fi 6(5GHz) 产品。

Q: 能介绍一下 RISC-V 的产品系列吗? ESP32-H2 什么时候会比较大量地出货?

A: 目前我们的产品线 ESP32-C3、ESP32-C6、ESP32-H2 都是基于 RISC-V 核。对于 ESP32-H2 未来的出货,我们暂时不能给出预测。但我们现在是少数几个过了 Matter 官方认证的平台。谷歌发布的开源 Matter 项目的例子就是基于 ESP32,还有基于 ESP32-H2 的。所以如果有标准的变化、底层的技术难点要攻克,我们都是走在比较前列的。另外我们 ESP32-H2 有样片之后,已经开始给一些客户送样。虽然还没到大规模推广阶段,但是大家还是有很强的意愿先做预研,提前做好准备,到正式大规模推广的时候,这些预研好的产品马上就可以量产,抓住进入市场的先机。目前我们已经有不少客户着手研发基于 ESP32-H2 的产品了。

Q: 用户开发 RISC-V 核的芯片会增加新的学习成本么?

A: 由于我们坚持技术自研,也包括了操作系统、编译器、工具链等,因此我们会为用户提供一整套的物联网开发框架,兼容 RISC-V 核和非 RISC-V 核的产品线,所以可以支持公司全系列芯片,因此用户熟悉了 ESP32 的开发环境后,切换到 RISC-V 核的 C3 或其他芯片也会非常便捷,不会额外增加学习成本。

Q: ESP32-H2 有没有预估市场空间?

A: 我们现在很难评估。此前物联网大多数企业的产品是基于 Wi-Fi 连接的,海外主要的平台代表为苹果、亚马逊、谷歌,之前这三个平台是不打通的,在某种程度上限制了 IoT 的增长速度。现在这三家都支持

Matter 协议，他们的产品就可以互联互通。所以我们认为有了这个标准之后，IoT 的增长会更快。

Q: 关于 Matter 协议，前面提到可能会加快行业的增长。请问这个协议对咱们产品端、研发端有怎样的影响？

A: 其实研发符合 Matter 协议的过程和研发 Wi-Fi 芯片类似，虽然不一样，有些东西需要重新做，但内核、软件平台等一些已经成熟的研发成果是可以复用的。我们可以根据像 Thread/Zigbee 这样新的标准，在软件上加新的功能以适配。我们拥有自研的软件操作系统、底层的开发框架，有利于每一代新芯片的开发。由于整个软件开发平台是一致的，开发者可以很便捷地沿用以前的开发环境，不用再学一套新东西，只需改变调用的一些接口，比如原来开发 Wi-Fi 产品的工程师，也可以用同一套平台参与开发 Thread 产品。

Q: 符合 Matter 协议的产品会马上放量么？

A: 预计 2022 年上半年该协议认证标准会确定，在认证标准确定后，客户会加速向市场推出相关产品。目前是以预研为主。

Q: 我们是唯一符合 Matter 协议的芯片公司么？

A: 还有其他芯片公司，具体名单可参见 Matter 的官方网站披露。

Q: 咱们公司产品的生命周期是比较久的？

A: 对，整个行业有这样的特征。而且有些大型的家电客户会要求供货保证 12 年，因此我们所有的产品都承诺 12 年的产品供货周期（详见官网）。

Q: 咱们产品的生命周期很长，产品迭代不是很快，如何阻挡友商进入？

A: 我们对自己每一代产品的定义是要做“终点站产品”，而不是先做个 60 分产品上市后再去迭代优化，所以它的生命周期也就较长了。ESP8266 在 2014 年上市后获得大量用户认可，现已畅销 7 年之久。在 2016 年推出的 ESP32 这条产品线仍在高速增长，深受用户欢迎。当新的 ESP32-C3 发布后，为客户提供了一个新价位区间的产品线选择，目前增速非常快。而在更高端的市场上，我们则提供带 AI 指令集功能的 ESP32-S3 产品线，且未来会不断研发更强处理能力的产品线向上延伸。从低至高，乐鑫正在形成更完整的产品矩阵。用户对于乐鑫产品的品质、生态的完整度、性能的保障以及品质一致性都是非常有信心的。用户会偏向选择拥有完整无线 MCU 产品线的公司为他们提供服

务，这样会不断有新产品能升级，或者填补细分市场，以助其自身未来产品的多样化。

Q: 现在做产品的升级，主要的技术指标除了 Wi-Fi 6 方向，有往处理性能等其他方面的发展吗？未来三年产品的定位方向如果往高端去走，我们瞄准的是哪些目标应用的市场？

A: 我们的定位仍是 Wireless MCU。其实 Wi-Fi 6 有多个标准，有 2.4G 和 5G 的，还有 Wi-Fi 6E、之后有 Wi-Fi 7，Wi-Fi 协议一直都有在升级，蓝牙协议也一样；在“连接”方面我们会追随国际标准升级我们的产品线，也会增加像 Thread/Zigbee 这一类无线标准。此外就是 MCU 部分的进化，我们现在已研发出单核 160MHz MCU，接下去还会不断进化，推出双核 240MHz，400MHz 的无线 MCU，一代一代往上做，不断加强处理性能，进入高端无线 MCU 市场。“连接”和“处理”其实只是我们宣传的最主要的核心点，但是在 data sheet 中，你会发现大量的其他的功能。现在我们可以通过排列组合推出不同的产品线去覆盖不同的细分领域。

Q: 大客户的软件生态或软件相关的服务的附加值是不是比中小客户或开发者用户的附加值低？

A: 我们认为软件生态可以为客户赋能。乐鑫投入了近 10 年的时间和大量人力去做软件。不论是大客户还是中小客户都是受益的，并不存在大客户不关心软件的情况，软件也同样会决定产品的品质稳定性。大客户反而会更在乎软件的成熟度和可扩展的潜力，因为它不仅仅是对接自己的产品，它有可能会上各种云，会需要跟其他的平台对接；比如他也会考虑是不是要接 Matter。他会看中乐鑫这个供应商能够帮助他进入更广阔的领域。因为智能化的产品已经不是一个孤品了，大客户有更多的因素要去考虑。

Q: 明年还会有多少新品？

A: 还会有，请以新闻发布为准。

Q: 公司现在已经做到 Wi-Fi MCU 市占率 35%，后面增长来自哪里？

A: Wi-Fi MCU 市场的增速主要还是受益于行业自身的增长，目前行业智能化渗透率仍较低。此外，我们产品矩阵现在已经不局限于 Wi-Fi MCU，还会进入新的市场，比如今年我们进入了 Zigbee/Thread 芯片市场，接下去还会进入 AI MCU 市场，另外 Wi-Fi 市场也会有新的增长点，例如 Wi-Fi 6/6E 市场。

Q: 未来一年研发人员数量的扩张态势?

A: 平稳扩张。

Q: 第四季度费用环比增长的趋势?

A: 绝对值还会继续提升, 但不会太多, 主要是人力成本(费用里大概70%-80%是人力相关成本和股份支付费用)。人才一直是公司的核心投入, 所以费用还会继续增长。

Q: 有人评价公司是利用了低人力成本所以才有成本优势的, 公司怎么看这种观点?

A: 中国的工程师人力成本并不低了, 我们愿意用好的价格招聘到好的技术人才。我们的成本优势是来自于我们的设计技术, 这是技术推动的成本控制领先。

Q: 伴随着海运修复叠加圣诞旺季, 听说下游成品库存快速出清, 请问公司是否感受到如此?

A: 我们直销为主, 客户本身压库存的情况较少。下半年我们一直是供不应求的状态, 有订单无法满足, 供应是主要瓶颈, 并非在需求端。

Q: 今年有透支明年的需求情况吗? 如何看待未来整个行业的增速?

A: 目前行业智能化渗透率仍偏低, 我们认为整个物联网行业还会保持快速增长。目前应该还不足以到透支的程度。

Q: 公司领导对公司未来的规划和愿景?

A: 我们希望产品真正能改变很多用户体验, 实现智能化生活, 未来希望我们的产品的应用场景更广泛。我们是一家喜欢做研发的公司, 并且重视培养人才, 人与人之间的合作可以激发新的思想, 我们要慢慢建立起这样的体系。